

F PCB打样,电路板加工,线路板定制,HDI盲埋孔PCB抄板供应商

产品名称	F PCB打样,电路板加工,线路板定制,HDI盲埋孔PCB抄板供应商
公司名称	深圳市祺利捷电子有限公司
价格	5.00/pcs
规格参数	PCB品牌:祺利捷PCB PCB型号:qljhdipcb098 产地:深圳沙井
公司地址	深圳市宝安区沙井街西环路上星西部工业园1001号C栋3F
联系电话	38118788 13728600798

产品详情

深圳市祺利捷电子www.qlelectrons.com是一家专业加工高精密度双面、多层刚性PCB打样,电路板加工,线路板定制,HDI盲埋孔PCB抄板供应商,单面 双面高导,大功率LED铝基板电路板,热电分离、绝缘孔工艺LED铝基板抄板打样定制型厂家

AB.PCB板 FPC软板 金属铝基板 软硬结合板技术加工参数

1. 表面工艺：喷锡、沉金、沉锡、沉银、碳油、OSP膜等。
2. 可加工层数：普通FR4硬板1-28层，铝基板：1-2层，FPC1-10层，软硬结合：2-10层
3. 最大加工尺寸：单面/双面板550x1500mm
4. 板厚0.3mm-3.2mm最小线宽0.05mm最小线距0.05mm
5. 最小成品孔径 $\phi 0.1\text{mm}$
6. 最小焊盘直径0.25mm
7. 金属化孔孔径公差 $0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$
8. 孔位差 $\pm 0.05\text{mm}$
9. 绝缘电阻 $> 10^{14}$ (常态)

10.孔电阻 300 u

11. 抗电强度 1.6Kv/mm

12. 抗剥强度1.5v/mm

13. 阻焊剂硬度 > 5H

14. 热冲击288 10sec

15. 燃烧等级94v-0

16. 可焊性235 3s在内湿润翘曲度board Twist < 0.01mm/mm离子清洁度 < 1.56微克/cm²

17. 基材铜箔厚度：0.5oz 1oz 2oz 3oz

18. 镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米

19. 常用基材：FR-4、Rogers、CEM-1、CEM-3、94VO、94HB FPC F4BM-2、铝基、铜基、PET、陶瓷

AC.下单注意事项

D. 客户下单需提供以下资料，

1，设计文件可接受文件：GERBER文件、PADS文件、PROTEL文件、DXP文件、CAM/TGZ文件、CAD/DXF文件或实物样板，

2，客户信息，联系方式，收货地址及联系人。